

Sapphire+Er,Yb:Glass+Co:Spinel



描述

我司Sapphire+Er,Yb:Glass+Co:Spinel键合晶体，是在Er,Yb:Glass两端键合Sapphire和Co:Spinel形成的键合晶体，可以有效的改善Er,Yb:Glass的综合性能。

两端键合Sapphire和Co:Spinel形成Sapphire+Er,Yb:Glass+Co:Spinel键合晶体，可以有效改善Er,Yb:Glass晶体的热效应，降低激光泵浦时形成的热透镜效应，吸收带宽，荧光寿命长，光学质量高，斜率效率高。改善激光的光束质量，提升1535nm激光输出效率，并能提升激光器的输出能力稳定性，提升激光器的使用寿命。

使用表面活化键合技术，是一种低温或者常温下的键合技术，典型特征是表面清洗和表面活化。在键合前，通过快原子或者离子束对键合表面的轰击，可以有效的增加键合强度，实现对无机材料、金属、半导体材料间的高质量键合。与高温热键合方法相比，表面活化键合技术键合结合力界面较高、光吸收损耗和面形变化控制相对而言更优，而热扩散键合表面的杂质去不掉，被键合在结合面。表面活化键合技术有去除各种抛光的残留成分、去除有机污染物、去除表面氧化层和打断材料化学键，提升活化能等优点。

生产的Sapphire+Er,Yb:Glass+Co:Spinel键合晶体的键合强度高、键合面吸收损耗小（一般小于20ppm）、键合面面形变化小（键合后面形 $<\lambda/8$ ）。键合晶体的形状可以是棒状、板状、波导或者三明治形状。在键合晶体两端可以提供多种类型的镀膜，如两个端面增透膜AR@1535nm，或者S1:HR@1535nm+AR@940nm，S2:AR@1535+HR@940nm等。Sapphire+Er,Yb:Glass+Co:Spinel键合晶体广泛应用于测距仪，雷达，目标识别等领域广泛应用。

特点

- 可以有效改善Er,Yb:Glass的热效应
- 降低激光泵浦时形成的热透镜效应
- 吸收带宽，荧光寿命长，光学质量高，斜率效率高
- 改善激光的光束质量，提升1535nm激光输出效率
- 能提升激光器的输出能力稳定性，提升激光器的使用寿命

应用

- 测距仪
- 雷达
- 目标识别



Sapphire+Er,Yb:Glass+Co:Spinel

参数

Sapphire+Er,Yb:Glass+Co:Spinel			
材料	Sapphire	Er,Yb:glass	Co:spinel
掺杂浓度	/	0.5%\1.0%\1.5%	/
初始折射率	/	/	30 ~ 99%
晶体结构	Rods/Slabs/Sandwich/Waveguide/		
端面配置	Flat/Convex/Wedge		
侧面配置'	Polish/Fine Ground		
镀膜	AR@1535nm	/	AR@1535nm
	HR@1535nm+AR@940nm	/	PR@1535+HR@940nm
	others	/	others



有什么问题请联系我们的
技术工程师，在线为
您解答



了解更多资讯，请关注
我们的公众号--上海芯
飞睿科技有限公司